

特点:

- 高阻带抑制:
典型值 60dB @ $f_0 \pm 25\text{MHz}$
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: $20 \times 10 \times 5.5\text{mm}^3$
- 产品执行标准为 GJB8481-2015

性能参数: (TA=25°C)

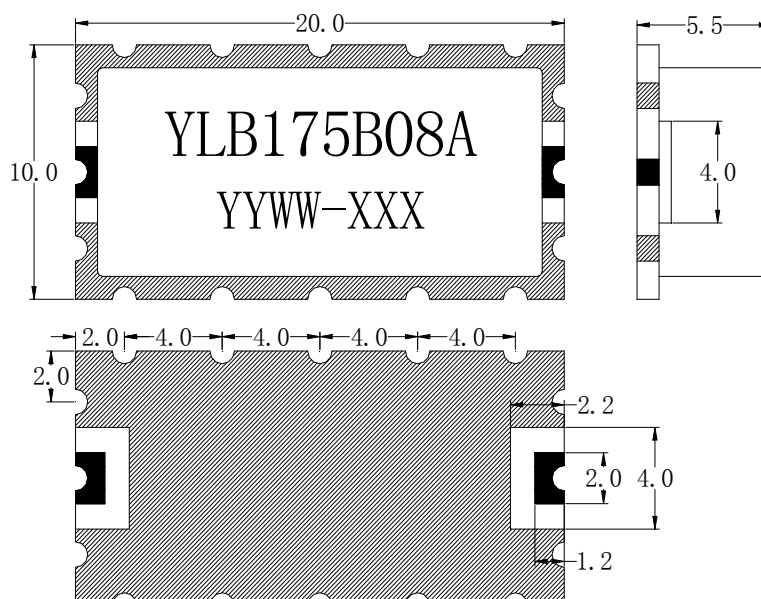
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	f_0		175 ± 0.8			MHz	全温
-3dB 带宽	BW_{-3dB}		7		9	MHz	全温
插入损耗	IL	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=175\text{MHz}$		8.0	9.0	dB	全温
输入带内驻波比	VSWR _i	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=172\sim 178\text{MHz}$		1.5:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		全温
阻带抑制	SR ₁	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=1\sim 150\text{MHz}$	60	65		dB	全温
	SR ₂	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=200\sim 500\text{MHz}$	60	65		dB	全温
输入输出阻抗				50		Ω	
工作温度	T		-55		+85	°C	
质量	m				5.0	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
输入射频功率	+30.0	dBm	储存温度	-55~+100	°C

封装外形及引脚标识图:

单位: mm 公差: ±0.2mm



字符标志:

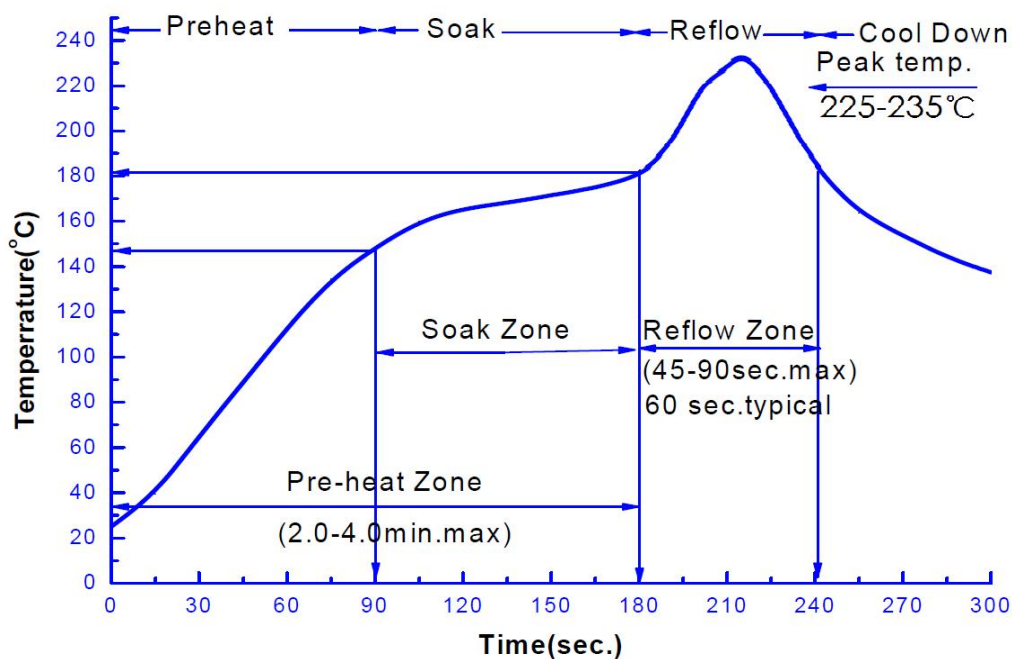
YLB175B08A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

接口标识	接口说明
■	RF IN, RF OUT (可互换)
▨	GND

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件, 产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护;
2. 产品使用时请保证接地良好 (GND 引脚和底部金属化区域), 为了保证连接良好, 底部引脚焊好之后, 需对侧面引脚进行补焊;
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 采用 Sn63/Pb37 锡膏, 熔点 183°C 回流焊接, 回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线, 因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过 220°C。

4. 如特殊情况需采用手工焊接, 烙铁温度 350°C, 焊接时间不超过 3 秒; 回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装, 存放条件: 温度 10~35°C, 湿度 35~65%RH; 对于需长期储存 (超过半年) 产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境, 客户在对产品焊接及清洗完成后, 应对宇熙产品进行三防喷涂处理, 以提高产品耐环境适应性能力。